

Компетентное мнение

Расширенное совещание руководителей предприятий радиоэлектронной промышленности.....	4
В. Минаев.	
Итоги работы радиоэлектронной промышленности в 2008 году и основные задачи на 2009 год	10
Третий Всероссийский Форум руководителей предприятий-производителей электроники "Новая электроника России"	18
В. Макаров.	
Производство печатных плат: лучший мировой опыт доступен в России	20
НОВОСТИ	26

Элементная база электроники

В. Шурыгина.	
КМОП- и ПЗС-датчики изображения. Впереди светлое будущее.....	32
Д. Никишин.	
Соединители ODU MAC LC – удобные и экономичные	40
М. Самойлова.	
Пленочные конденсаторы компании AVX/TPC для преобразовательной техники железнодорожного транспорта.....	42
В. Буробин, А. Коновалов, Ю. Матвеев.	
Решение проблем энергосбережения. Вклад ФГУП ГЗ "Пульсар"	48

Новые технологии

С. Аваков, Г. Ковальчук, С. Русецкий, Е. Титко.	
Оборудование ГНПО "Планар" – регионам России	52
Е. Назаров.	
Производители РЭА голосуют за технологию внутреннего монтажа.....	58
Е. Берлин, Л. Сейдман.	
Нанесение толстых диэлектрических покрытий в вакууме. Технология и оборудование. Часть I	66
М. Гольцова.	
Рынок технологического оборудования: цунами налетел	72
И. Викулов.	
Корпусирование СВЧ-микросхем на пластине. Технология, преимущества, результаты	74
Е. Мухина.	
Технология обработки ультратонких полупроводниковых пластин	80
Ад ван Динтер, О. Зотова.	
Что необходимо знать о технологии нанесения защитных покрытий?.....	82
В. Скабаро.	
"Легкое видение" – новая концепция систем технического зрения OMRON	86

Микропроцессорная и вычислительная техника

Н. Елисеев.	
Atom-ные ядра для встраиваемых систем	90

Печатный монтаж

Е. Бегер.	
Паяльная маска: особенности проектирования и изготовления.....	94

Контроль и измерения

А. Матвиенко.	
Анализ радиочастотных сигналов: проблемы и решения	100